**2020·光刻胶先进技术和产业应用研讨会**

**参会回执**

**（请于2020年9月10日前将参会回执发邮件tj@cemia.org.cn）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | |
| **姓 名** | **职务** | **电话** | **手机** | **邮箱** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **住宿订房**  **数量** |  | | | |
| **备注** |  | | | |